



執行役
イノベーション推進本部長

吉田 誠人

グローバル成長実現のための 新製品・新事業開発に向けた オープンイノベーションの取り組み

Approaches of open innovation
to develop novel products
and businesses for global market growth

1962年の創業以来、日立化成は、源流製品である絶縁ワニス、積層板、絶縁ガイシ、カーボンブラシの開発・製造で培った「材料技術」と「加工技術」を融合して、時代に先駆けた新製品を創出し、市場ニーズを先取りした研究開発型企業として競争力の強化を図ってきました。

これまで、当社では、製品のアイデアを実現するための研究開発は自部門で包括的に行うことが常識となっていました。しかしながら、顧客ニーズの多様化、製品ライフサイクルの短縮化、市場のグローバル化による競争構造の変化などが要因となって、製品に求められる特性が高度化し、すべての研究開発を自前で実施するやり方が限界に達してきました。従来から、基盤技術強化を目的に、日立グループや国内外の大学、研究機関等と連携を深めてきましたが、他社に先駆けた新事業創出のために、既存のネットワークの外にある技術を活用する目的で、「オープンイノベーション」という戦略的手法を新たに取り入れることにしました。

オープンイノベーションは、2003年に、ハーバード大学のヘンリー・チェスブロウ教授が提唱した考えで、自社内のアイデアや技術だけに依存するのではなく、他社との協業を積極的に活用することによって、革新的で新しい価値を創り出し、新事業創出の速度向上を実現する重要な考え方です。オープンイノベーションは、革新的な技術の取り込みだけでなく、販路や製造場所など、事業化のために最適なりソース(経営資源)を必要となるからタイムリーに確保するための戦略的な手法です。現在、導入段階ではありますが、当社が取り組んでいるオープンイノベーションの状況を以下に紹介します。

「オープン・ラボの活用」

半導体実装材料の開発において、半導体パッケージの技術がより高度になっていることに加え、製品サイクルが短く、短期間で実装材料を開発し、提供することが重要になっています。そこで、2014年6月に半導体実装材料技術の強化と開発期間の短縮ならびに将来ニーズの先取りを目的に「オープン・ラボ」を開設し、半導体実装メーカーはもとより、装置メーカーや実装材料メーカー等を巻き込んだオープンイノベーションを実践しています。

また、半導体実装材料にとどまらず、当社が保有する幅広い技術と将来のマーケットをつなぐ新しい場として、イノベーションセンタを開設します。お客様、セットメーカー、装置メーカーや事業を取り巻くステークホルダーと一緒に将来のニーズを掘り起こす「協創の場」としての機能をめざします。そこでは、発想を促進する快適な空間、体験型の当社コア技術の展示、分野を超えた幅広い対話と議論ができるミーティングプログラムを準備し、お客様をお待ちいたします。そこから作り出される新製品、新事業にご期待ください。

「外部機関の活用」

未上場成長企業への投資ファンドであるベンチャーキャピタルや、ニーズとシーズを企業間に紹介するビジネスマッチングなどの外部機関を活用し、技術ライセンスの取得、M&Aや共同開発、相互販売などの業務提携を積極的に行い、事業化のスピードを加速しています。昨年5月から、米国ベンチャーキャピタルに投資を開始するとともに専従者を配置して、技術探索を開始しました。日立化成アメリカならびに日本側の部署との連携によって、ベンチャー企業や研究機関の最新情報を収集し、社内の研究開発部門、関連事業部へ展開しています。昨年一年間で、約2,000件のベンチャー情報を入手し、有望技術の検討、導入を開始しました。米国から導入したナノテクノロジーを応用した機能性フィルムは、ディスプレイ向けの高機能材料として製品化を進めています。

これらオープンイノベーションの活用を促進して新たな企業文化として根付かせるとともに、新事業、新製品の創出を加速して、時代を拓く技術、製品、サービスの提供を継続し、豊かな生活とより良い社会の実現をめざします。